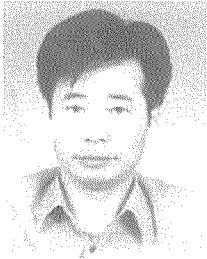


# (주)케스텀



## 대표자 경영철학



“밀레니엄 시대에 있어서 첨단 기술을 바탕으로 한 제품의 質은 곧 사업의 생명선이며 성공과 실패를 좌우하는 중요한 요소입니다. 시대가 바뀌어 이제 현

시대는 회사의 규모나 크기로 경쟁하는 시대는 지나갔습니다. 규모가 작은 회사도 다윗이 골리앗을 쓰러뜨리는 것과 같이 거대한 회사의 장벽을 넘어 끈끈한 생명선을 유지하며 키워 나가는 것은 바로 핵심적인 경쟁의 무기인 첨단 기술인 것 입니다.

첨단 기술개발의 시작은 불가능에 대한 끊임 없는 도전과 고정 관념의 틀을 과감히 깨뜨리는 사고와 발상의 전환에서 비롯됩니다. 따라서 제가 가장 강조하는 것은 바로 창의와 도전 정신이며 이에 당사의 사훈도 “창의·도전·인

- 대표이사 : 조 상 천
- 주 소 : (406-130)인천시 연수구 동춘동 994 송도테크노파크 207호
- 전 화 : 032-833-0061
- 팩 스 : 032-450-0760
- 설립일자 : 2002. 9. 3
- 주생산품목 : MLP(Multi Layer Package), CLAD-Lid
- 자본금 : 100 백만원
- U R L : www.castom.net

화” 입니다. 이것이 오늘날 우리 케스텀의 명맥을 유지하는 생명선의 원천이며 미래의 세계적인 첨단 기술 기업 케스텀주식회사의 밑거름이 될 것이라 확신 합니다.

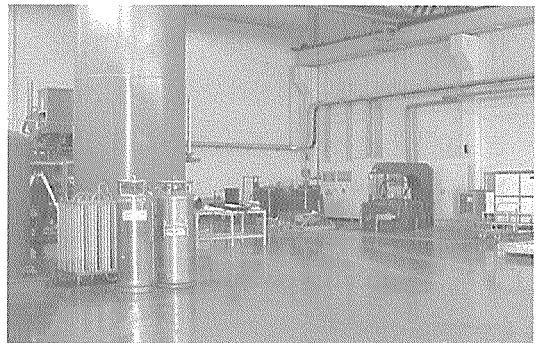
현재의 당사 연구개발비는 매출액 대비 7% 정도를 유지하고 있으나 차후 점진적으로 15% 이상으로 유지시켜 나아 갈 계획 입니다.”



## 회사 소개

바야흐로 IT 산업이 국가의 힘 즉 국력을 가늠하는 시대가 열리고 있다. 케스텀(주)는 국가의 기간 산업인 통신분야에서 코퍼니쿠스적 발상의 전환을 가지고 있는 사람들의 모임으로 2002년 9월에 설립된 신생 기업이다. “창의와 도전”을 모토로 세계 초 일류를 꿈꾸고 있으며 또한 이를 꾸준히 실현해 나가고 있다.

오픈 마인드의 소유자 조상천 사장님은 불후의 나이가 넘었음에도 불구하고 시간이 날 때



마다 젊은 직원들과 스타크래프트를 즐기는 등 때로는 친구로서, 때로는 직장 동료로서 또한 때로는 직장 상사로서 가족적인 분위기를 이끌어 가고 계시며, 이하 임직원들은 모두가 주인 의식을 갖고 오늘도 깊어 가는 야밤의 적막 속에 연구개발실의 불을 밝히고 있다.

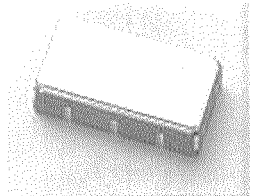
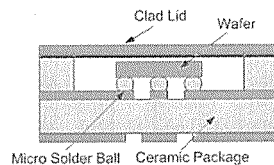
케스텀(주)는 비록 業歷이 짧은 신생 기업이기는 하나, 대기업에서 10여년 넘게 연구개발실의 책임자로서 활동 해 오신 조상천 사장님과 연구개발실 직원들은 현재 8개의 신기술 아이টে을 개발 완료 하였으며 이 중 가장 먼저 상용화한 신기술 개발품인 CLAD-LID는 국내는 물론 현재 세계특허를 출원 중에 있으며 금년 한국과 학기술정보원으로 부터 “신기술아이디어 평가 사업” 선정품목으로 채택되는 등 첨단 기술의 우수성이 대내외적으로 인정 받고 있다.

특히 이 CLAD-LID는 일본과 미국에서도 개발에 실패한 것으로서 더욱 그 우수성이 빛난다고 할 것 이다.

케스텀(주)는 이 CLAD-LID 뿐 아니라 연구 개발을 완료한 아이টে을들을 점차적으로 상용화해 나갈 계획이며 이를 바탕으로 2004년도 매출액을 40억원 정도 예상하고 있으며 2005년도에는 100억원 돌파를 목표로 매진하고 있다. 국내는 물론이지만 특히 해외 시장에 중점을 두어 마케팅 전략을 세워나가고 있으며 머지않아 세계 속에 케스텀(주)의 브랜드로 거듭 태어 날



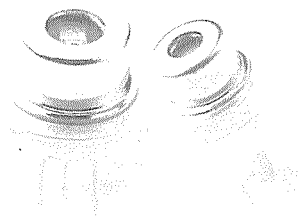
## CLAD-LID 제품 소개



CLAD - LID를 적용한 SMD PACKAGE 구조 및 제품 형상도

CLAD-LID는 차세대 MCP(Multi Chip Package)형 반도체 Package의 이형제 Sealing용 Cover로서 PDA, COMPUTER, HAND PHONE, MP3, GPS, 무선LAN, 위성방송수신기 등 거의 모든 전자제품에 적용하여 사용이 가능하다. 특히 2006년 부터는 환경 규제 지침에 따라 한국은 물론 유럽, 미국, 일본 등 전 세계적으로 납, 수은, 카드뮴의 유해 물질이 첨가된 전자제품은 생산을 할 수 없게 됨에 따라 이에 대체할 수 있는 신기술의 제품이다.

특히 본 기술은 초박형, 경박형, 소형화, Noise 문제 해결 등 전자 실드의 고 신뢰성 실현이 가능하며 제조 공정의 단축과 불량률 감소 등 제



조원가의 절감에도 획기적으로 기여할 수가 있어 향후의 시장성이 매우 밝다고 할 것이다.



## 연구개발 현황 및 향후 계획

건 더 있다는 사실이다. 다른 한편으로 보면 케스텀(주)는 제조 생산회사 라기 보다는 연구 개발을 전담하는 발명 회사라 해도 무리가 없을 듯 하다.

향후 케스텀(주)는 단기적으로 내년까지 12억 원을 투자하여 생산설비를 확충 할 계획이며 또한 세계시장의 진출을 위한 교두보로 일본에 지사 설립을 추진 중에 있다.

그러나 역시 신생 기업이기엔 한정된 자본으로 생산설비를 확보하는 데에 가장 큰 애로점이 있다. 그동안 케스텀(주)의 우수한 기술성을 알고 있는 몇몇의 투자자들이 투자를 의뢰하기도 하였으나, 당장은 어렵지만 일단은 동고동락을 함께하는 직원들과 함께 투지로 밀고 나가겠다는 조상천 사장님의 외고집 뚝심이 더 한층 케스텀(주)의 미래가 밝아 보이게 한다.

케스텀(주)에서 연구개발한 신기술 제품들은 모두가 세계적인 기술 수준이라 한다. 지금까지 개발을 완료한 제품 기술들은 “CLAD Type SMD Ceramic Package, MG Alloy 再 PRESS 제조 기술, DIP SAW DEVICES의 2중 Leak 방지 제조 기술, 저온 실장용 PCB판, CPU 냉각 FIN 제품” 등이 있다. 그러나 특이할 만한 것은, 다른 회사들은 한가지라도 더 특허를 출원하려고 애를 쓰고 있으나 케스텀(주)는 오히려 공개를 꺼려하여 특허출원을 하지 아니하고 극비에 붙인 첨단 기술이 몇

